

Diseño De Mango Para Portaoblas De Ptfе Personalizado Y Cesta De Flores Resistente A Productos Químicos Para Limpieza De Semiconductores

Número de artículo: PL-CP166



Introducción

Maximice el rendimiento de los semiconductores con portaoblas y cestas de flores de PTFE personalizados. Diseñados para una resistencia superior al ácido fluorhídrico y reactivos agresivos, estos sistemas de manipulación de alta pureza cuentan con mangos ergonómicos y ranuras mecanizadas con precisión por CNC para una limpieza en procesos húmedos segura y libre de contaminación.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Procesos de Limpieza RCA	Limpieza secuencial utilizando soluciones SC-1 y SC-2 para eliminar residuos orgánicos y contaminantes metálicos.	Resiste el pH alto y el estrés oxidativo sin lixiviar impurezas en el baño.
Grabado con Ácido Fluorhídrico	Eliminación de capas de óxido nativo o capas de vidrio sacrificial de obleas de silicio utilizando HF concentrado.	Resistencia completa al HF, que de otro modo disolvería el vidrio o degradaría los plásticos estándar.
Grabado/Decapado con Piranha	Eliminación de contaminación orgánica pesada o fotoresina utilizando una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno.	Mantiene la integridad estructural a las altas temperaturas exotérmicas generadas por las soluciones Piranha.
Revelado en Fotolitografía	Inmersión de obleas en soluciones reveladoras para definir patrones de circuitos después de la exposición a UV.	El ranurado de precisión asegura una exposición uniforme de la superficie de la oblea al fluido revelador.
Enjuague Post-CMP	Enjuague de alta pureza tras el Pulido Químico Mecánico para eliminar partículas de la suspensión.	La superficie antiadherente evita la acumulación de la suspensión y facilita una descontaminación rápida y completa.
Fab. de Semiconductores Compuestos	Procesamiento de obleas de GaAs, InP o SiC para electrónica de alta frecuencia y fabricación de LED.	Las características de manipulación suave evitan la fractura de materiales compuestos más frágiles.
Limpieza Ultrasónica / Megasónica	Soporte de obleas durante la limpieza acústica de alta frecuencia para desalojar partículas submicrónicas.	Excelente amortiguación de vibraciones y estabilidad química bajo fuerzas de cavitación acústica.

Categoría de Especificación	Detalles del Parámetro para PL-CP166	Opciones de Personalización
Material Principal	PTFE Virgen de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)	PFA opcional para mayor transparencia/pureza
Compatibilidad con Tamaño de Oblea	4 pulgadas (100mm), 6 pulgadas (150mm), 8 pulgadas (200mm)	Diámetros personalizados y formas no estándar disponibles
Configuración de Ranuras	Perfiles de ranura en V o ranura en U cortados con precisión	Paso, profundidad y espaciado angular de ranura personalizados
Capacidad	Configuraciones estándar de 25 o 50 obleas	Tamaños de lote a medida desde una sola oblea hasta alto volumen
Diseño del Mango	Mango integrado montado en la parte superior o lateral	Mangos desmontables, extendidos o compatibles con automatización
Resistencia Química	Espectro completo (Ácidos, Bases, Disolventes, Oxidantes)	Verificado para HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH, etc.

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Categoría de Especificación	Detalles del Parámetro para PL-CP166	Opciones de Personalización
Temperatura de Operación	-200°C a +260°C	Adaptado para perfiles específicos de ciclado térmico
Método de Fabricación	Mecanizado CNC Personalizado de Extremo a Extremo	Control de tolerancia de precisión para interfaz automatizada
Protocolo de Limpieza	Lavado en sala limpia y sellado al vacío	Pre-limpieza especializada para análisis de trazas